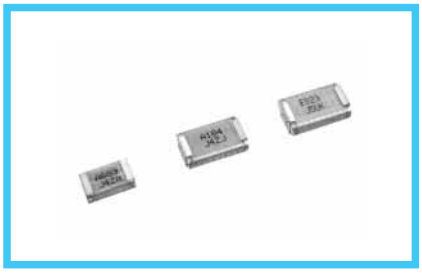
ML 系列

金属化PPS薄膜芯片电容器

表面安装品

- 高耐热性、高可靠性的无封装薄膜芯片电容器
- 最适用于液晶监视器、液晶电视、汽车导航系统、游戏机等的背光灯用扁平电源电路
- 对应无铅化的回流焊接用
- RoHS指令(2002/95/EC)已对应完毕

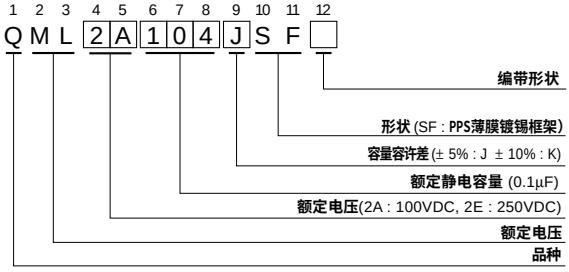


■仕样

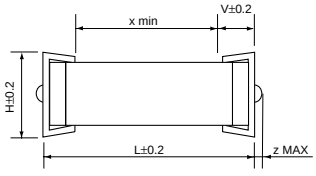
项目	性　　能
分类温度范围	−40 ~ +125˚C (额定温度:105˚C)
额定电压范围 (UR)	100V.D.C. / 63V.A.C. , 250V.D.C. / 80V.A.C.
额定静电容量范围	0.01 ~ 0.22μF
额定静电容量容许差	±5% (J), ±10% (K)
介质损耗正切	0.15% 以下 (1kHz 20˚C)
绝缘电阻	15,000 MΩ以上
耐电压	端子与端子之间 ： 额定电压(U_R)×150% 60s
封装	无封装（液状环氧树脂）
焊接耐热	回流 ：峰值 250˚C, 10S 以内
引用 规格	JIS C 5101-20, EIAJ RC-2349

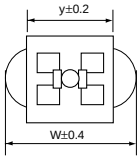
分类电压 = U_R × 0.8

品号编码体系（例 ：100VDC 0.1μF)



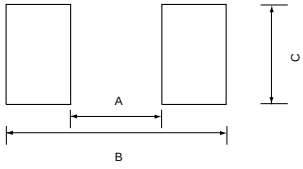
■尺寸表





焊盘尺寸

电压 (V)	Cap (μF)	A	B	C
100	0.01 ~ 0.15	5.5	10.0	4.0
250	0.01 ~ 0.056			
100	0.18 ~ 0.22	8.0	12.6	4.0
250	0.068 ~ 0.1			



■尺寸表

单位: (mm)

Cap.(μF)	品号编码 \ V(编码) 尺寸	100VDC / 63VAC (2A)								250VDC / 80VAC (2E)							
		H	L	W	v	x	y	z	编带编码	H	L	W	v	x	y	z	编带编码
0.01	103	3.0	8.1	5.2	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.2	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.012	123	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.015	153	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.018	183	3.0	8.1	5.2	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.2	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.022	223	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.027	273	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.033	333	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	5.5	1.2	5.1	4.2	0.3	A
0.039	393	3.0	8.1	5.2	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.0	8.1	6.3	1.2	5.1	4.2	0.3	B
0.047	473	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.5	8.1	6.3	1.2	5.1	4.2	0.3	B
0.056	563	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.5	8.1	7.0	1.2	5.1	4.2	0.3	B
0.068	683	3.0	8.1	5.3	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.5	10.6	7.1	1.2	7.6	4.2	0.3	C
0.082	823	3.0	8.1	5.5	1.2	5.1	4.2	0.3	A	3.5	10.6	7.2	1.2	7.6	4.2	0.3	C
0.1	104	3.0	8.1	5.8	1.2	5.1	4.2	0.3	B	3.5	10.6	7.8	1.2	7.6	4.2	0.3	E
0.12	124	3.5	8.1	6.1	1.2	5.1	4.2	0.3	B								
0.15	154	3.5	8.1	6.5	1.2	5.1	4.2	0.3	B								
0.18	184	3.0	10.6	6.8	1.2	7.6	4.2	0.3	C								
0.22	224	3.5	10.6	7.0	1.2	7.6	4.2	0.3	C								